

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成24年11月1日(2012.11.1)

【公開番号】特開2010-109351(P2010-109351A)

【公開日】平成22年5月13日(2010.5.13)

【年通号数】公開・登録公報2010-019

【出願番号】特願2009-226638(P2009-226638)

【国際特許分類】

H 01 L 27/04 (2006.01)

H 01 L 21/822 (2006.01)

G 06 K 19/07 (2006.01)

G 06 K 19/077 (2006.01)

【F I】

H 01 L 27/04 C

H 01 L 27/04 H

G 06 K 19/00 H

G 06 K 19/00 K

【手続補正書】

【提出日】平成24年9月18日(2012.9.18)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

集積回路と、共振容量部と、を備えたICチップと、

前記ICチップ上に設けられたアンテナと、

絶縁体を介して前記アンテナと少なくとも一部が重なるように設けられた導電性遮蔽体
と、

前記アンテナと、前記絶縁体と、前記導電性遮蔽体とを有する第1の容量素子と、を有
することを特徴とする半導体装置。

【請求項2】

請求項1において、前記共振容量部は配線を有し、第2の容量素子は、前記配線と、前記絶縁体と、前記導電性遮蔽体とを有することを特徴とする半導体装置。

【請求項3】

請求項1又は2において、前記絶縁体は、纖維体に有機樹脂を含浸させた構造体を有す
ることを特徴とする半導体装置。

【請求項4】

第1の導電性遮蔽体と、

前記第1の導電性遮蔽体上に設けられた第1の絶縁体と、

前記第1の絶縁体上に設けられた集積回路と、共振容量部と、を備えたICチップと、
前記ICチップ上に設けられたアンテナと、

前記アンテナ上に設けられた第2の絶縁体と、

前記第2の絶縁体上に設けられた第2の導電性遮蔽体と、を有し、

前記第1の導電性遮蔽体と、前記アンテナとは、前記第1の絶縁体及び前記ICチップ
を介して少なくとも一部が重なるように設けられ、

前記第2の導電性遮蔽体と、前記アンテナとは、前記第2の絶縁体を介して少なくとも

一部が重なるように設けられ、

第 1 の容量素子は、前記第 1 の導電性遮蔽体と、前記第 1 の絶縁体と、前記アンテナとを有し、

第 2 の容量素子は、前記第 2 の導電性遮蔽体と、前記第 2 の絶縁体と、前記アンテナとを有することを特徴とする半導体装置。

【請求項 5】

請求項 4において、前記共振容量部は配線を有し、第 3 の容量素子は、前記配線と、前記第 2 の絶縁体と、前記第 2 の導電性遮蔽体とを有することを特徴とする半導体装置。

【請求項 6】

請求項 4又は 5において、前記第 1 の絶縁体及び前記第 2 の絶縁体はそれぞれ、繊維体に有機樹脂を含浸させた構造体を有することを特徴とする半導体装置。